

证券代码：301095

证券简称：广立微

杭州广立微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 线上交流 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	长城基金、南方基金、华夏基金、中金公司、申万宏源、银华基金、汇添富、国泰基金、广发基金、广发证券、民生证券、银叶投资、国海证券、兴银基金、华泰柏瑞、长城证券、国联基金、太平洋资产、钦沐资产、文博启胜、国金证券、睿郡资产、红塔证券、信达澳亚、宏利基金、兴证资管、博时基金、浦银安盛、国投证券、中邮证券、浙商证券、民生证券共 32 家机构。
时间	2024 年 2 月 27 日-2024 年 3 月 18 日
地点	公司会议室
形式	现场会议、线上交流
公司接待人员	董秘兼财务总监：陆春龙 证券事务代表：李莉莉
交流内容及具体问答记录	一、公司概述 广立微是领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备供应商，公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术，是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。公司现已形成 EDA 设计软件、WAT 测试设备及半导体数据

分析工具相结合的成品率提升全流程解决方案，在集成电路从设计到量产的整个产品周期内实现芯片性能、成品率、稳定性的提升。

二、问答环节

1、请公司简单介绍 2023 年的业务概况？

2023 年，全球集成电路行业总体处于“周期下行-底部复苏”阶段，国内集成电路产业也面临着国际环境、产业周期等内外部环境的挑战。公司根据行业发展趋势推出解决客户痛点的高性价比产品，持续发挥全流程良率提升的软硬件协同优势，为客户提供高附加价值的产品和方案，并进一步拓展集成电路设计类客户，公司年度业绩保持稳定增长态势。另一方面，公司积极布局海外市场，设立了新加坡全资子公司，便于进一步开拓东南亚市场，同时参股了韩国合作伙伴，为做深韩国市场奠定坚实基础。

在新产品研发方面，公司持续加大投入，不断加强技术研发深度和产品迭代升级，横向拓展制造类 EDA 和晶圆级电性测试设备品类的覆盖广度并取得较大进展，例如：在 EDA 软件方向，公司新增推出了可制造性 DFM 软件、可测试性 DFT 软件并全线升级半导体大数据平台系列产品，为未来的业务增长积累势能并提供强有力的支撑。

在并购方面，公司持续关注行业动态，积极寻求具备高水平技术能力、高度认可广立微经营理念且与广立微业务具备协同效应的同行业公司作为潜在并购标的，以实现公司业务领域的快速拓展。2023 年，公司完成了对上海亿瑞芯电子科技有限公司（以下简称“亿瑞芯”）的股权收购并使其成为控股子公司，实现了上市以来的首个并购案例。亿瑞芯是一家以集成电路可测试性设计（DFT）技术服务及产品开发为主营业务的高科技企业。DFT 深度连接芯片设计与制造两端，在现代数字芯片设计中占据着越来越重要的地位，随着车规电子和大芯片的

发展,预计 DFT 市场会有更大的发展空间。广立微的现有 EDA 软件应用场景集中在集成电路制造环节, DFT 技术能够与公司的良率提升系统协同互补,完善公司的良率提升总体解决方案,为设计公司、晶圆厂提供更完整的方案,同时也能够成为广立微进军设计公司的核心抓手,对公司的业务扩展和布局具有积极的战略意义。

2、公司如何看待收并购对企业发展的作用,是否在此方面有所规划?

上市公司收并购是一种加快企业做大做强的重要手段,而 EDA 行业具有产品链长、工具品类繁多、技术门槛高等特点,纵观国际 EDA 龙头企业的发展史均是频繁的收并购史,通过收并购加快产品矩阵布局、整合提升企业的竞争力,成长壮大并发展成为业界顶尖企业。

公司将借鉴 EDA 产业界的成功经验,根据企业的总体规划,立足自身稳健发展的同时,积极关注与公司业务相关领域的发展情况,综合考虑内外部的多方面因素,合理运用资本工具加速公司成长和发展,助力公司不断提升综合实力和市场竞争力。同时,公司也将严格遵守相关法律法规的要求,当出现上述重大事项时及时向广大投资者披露。

3、人工智能技术的发展越来越快,公司如何看待其对集成电路特别是 EDA 软件方面的影响?

人工智能与集成电路是两个相辅相成、相互促进的技术领域。人工智能的基础底座是高性能芯片,集成电路作为电子信息产品的关键部件,为人工智能技术的发展奠定了坚实的基础;相应地,人工智能的快速发展带动了更高性能、更低功耗集成电路的需求,同时人工智能强大的算法和学习能力能够提升软件设计效率和性能并助力智能制造的实现,从而促进集成电路产业的技术进步和创新。

公司长期专注于 EDA 产业,并在芯片成品率提升领域形成

了包括 EDA 软件、WAT 测试设备和半导体数据分析软件在内的全流程产品生态构建。同时，公司高度关注人工智能方向的发展，积极拥抱技术变革，推动公司的 EDA 工具及半导体数据分析软件持续迭代更新，不断提升软件的设计与分析效率、精准度等性能，例如：公司通过机器学习、深度学习、计算机视觉等技术融入公司的半导体大数据平台，实现数据的快速准确管理、统计及分析，同时正在应用于在线数据分析系统的开发，拟解决海量数据的实时获取分析、及时并反馈正确结果以阻止损失或修正误差、与客户自有控制系统高度融合等技术难题。因此，我们认为人工智能技术的发展对集成电路特别是 EDA 领域有非常积极正向的促进作用。

4、公司能否简要介绍 2024 年的产品研发布局？

公司深耕集成电路 EDA 软件及晶圆级电性测试领域十数年，对集成电路多维度良率提升有深刻的理解和认识，结合公司软硬件协同的产品特点，使得公司能够在产品与技术研发上展现出良好的延展性和独特的优势，公司管理层对公司的发展战略及业务布局均有着清晰的规划并保持高度的信心。2024 年公司在产品研发上布局主要包括：

（1）持续深化集成电路良率提升解决方案：优化研发量产 PCM 方案，将先进电性监控方法和 EDA 工具从工艺开发环节向量产环节拓展，帮助量产线进一步提高产品成品率；

（2）拓展布局可制造性 EDA 软件：迭代优化化学机械抛光工艺的建模工具 CMP EXPLORER，并扩展更多 DFM 系列产品；

（3）赋能开发可测试性 EDA 软件：公司的可测试性设计 (DFT) 设计软件已发布，我们将持续与控股公司亿瑞芯、战略合作伙伴针对车规级应用等延伸开发相关 DFT 软件；

（4）持续布局半导体数据分析与管理系统：推进较成熟的离线数据分析软件（DE-G、DE-YMS、DE-DMS 等）产品 AI 智能化研发和商务落地，加快在线数据分析软件（DE-FDC、DE-SPC

	<p>等) 产品的布局开发;</p> <p>(5) 不断丰富晶圆级电性测试设备品类: 除现有 WAT、WLR 测试设备产品外, 公司根据应用场景不断拓展开发设备产品品类以满足日益发展的技术需求。</p> <p>(6) 积极布局和拓展海外市场, 推动硬件业务、良率服务方案和数据分析软件业务在海外客户的落地, 对公司业务形成新的增长引擎。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件 (如有, 可作为附件)	无。
日期	2024 年 3 月 19 日